

섬유개발연, 산업용 섬유 공동개발 MOU 체결

대구의 한국섬유개발연구원은 전자부품연구원(KETI)과 전자제품에 사용되는 산업용 섬유를 공동 개발하는 내용의 양해각서(MOU)를 체결했다고 8월6일 발표했다.

이에 따라 기능성 디스플레이 및 전자부품, 전자과 제어 섬유, 스마트 섬유 등에 대해 산·학 연구단을 공동 조직해 실용화 연구에 나설 방침이다.

섬개발연 관계자는 “전자 산업에서 필요한 부품 소재를 파악한 뒤 이에 맞게 산업용 섬유를 고안할 수 있어 R&D 효율성이 높아질 것으로 기대한다”며 “산업용 섬유를 특정 산업과 연계해 연구할 수 있어 상업적으로도 성공적인 모델이 될 것”이라고 밝혔다.

<화학저널 2007/08/06>